

CCI & MEC

Ваши партнеры по подготовке поверхности



Virginie HENRIOT
24-26 марта 2015
Москва, Россия

ОБЗОР

- ◎ Растворы для снятия фоторезиста и защитной паяльной маски
 - RISTOFF C-8
 - RISTOFF C-53
 - RISTOFF C-71
- ◎ Коричневый оксид
 - MEC V-BOND BO7710 V
- ◎ Флюс
 - MEC HASL FLUX W-2365 XP
- ◎ Раствор для снятия металлорезиста
 - MEC REMOVER S-1728
 - MEC REMOVER NH-1866

Фоторезист / Защитная паяльная маска

- RISTOFF C-8 : Снятие защитной маски
- RISTOFF C-53: Снятие фоторезиста
- RISTOFF C-71: Снятие фоторезиста
(базовый состав Моноэтаноламин)

RISTOFF C-8

**Процесс, экономия производителей
PCB в Европе составляет несколько
тысяч € в год**

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Защитная паяльная маска

ОСОБЕННОСТИ:

- Полностью удаляет защитную маску
- Без остатков
- Базовый состав 100% щелочь
- Не влияет на основание ламината

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

РАБОЧИЙ РАСТВОР:

Концентрация (1:1)

⇒ Развести 50% концентрата
дистиллированной водой

ПРОЦЕСС:

- ⦿ Температура 55-60°C
- ⦿ Время процесса < 45 мин до 2 час

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

Ristoff®

Creative Chemistry In Action

- Sun Chemical-Imagecure® range
- Taiyo-PSR Series
- Probimer® 77
- Lakwerke Peters Elpemer® range
- Electra-Carapace®
- Tamura-DSR Series
- Elga-OPSR 560

Все успешно обработаны с помощью C-8

RISTOFF C-53

В настоящее время заменяет все
растворы для снятия сухого
пленочного фоторезиста

Раствор для снятия фоторезиста RISTOFF C-53

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Сухой пленочный фоторезист

ОСОБЕННОСТИ:

- Базовый состав ТМАН и моноэтаноламин
- Без растворителей и каустической соды
- Эксклюзивный, уникальный антикоррозийный раствор -> Меньше помех при измерении OAI и оставляет лужение в исходном состоянии
- Устраняет проблемы замедленного травления, вызванного путем осаждения сплавов металла, особенно на медной поверхности толщиной (5,9,12 мкм)
- Может использоваться для всех сухих фоторезистов :
 - Наружные-внутренние слои (кислое и щелочное травление)
 - Покрытие никель/золото

RISTOFF C-71

Заменит все используемые в
настоящее время растворы для
снятия фоторезиста

РАСТВОР ДЛЯ СНЯТИЯ ФОТОРЕЗИСТА RISTOFF C-71

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Сухой пленочный фоторезист

ОСОБЕННОСТИ:

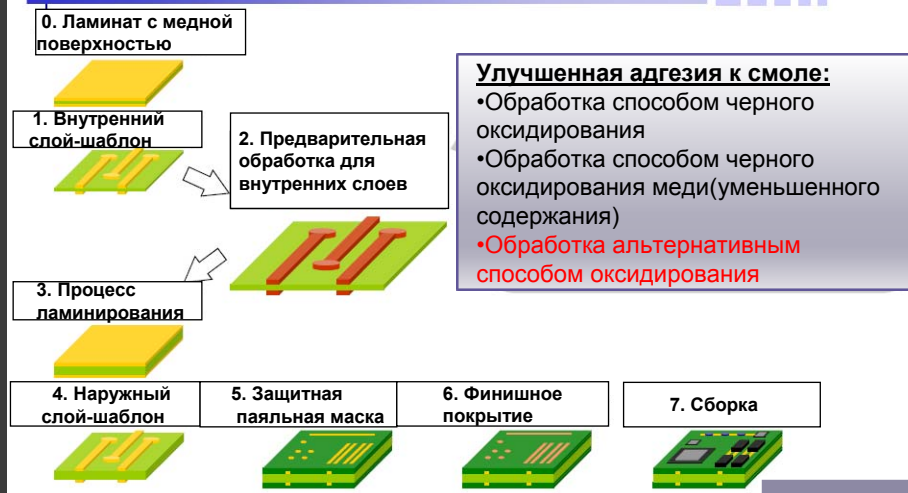
- Экономичный раствор для фоторезиста
- Базовый состав Моноэтаноламин
- Без Каустика, Растворителя и ТМАН
- Используется для наружных слоев и кислого травления (Не используется для Nickel/Gold или щелочного травления)

MEC V-BOND BO7710 V

Brown oxide Экономичный раствор

КОРИЧНЕВЫЙ ОКСИД MEC V-BOND B07710 V

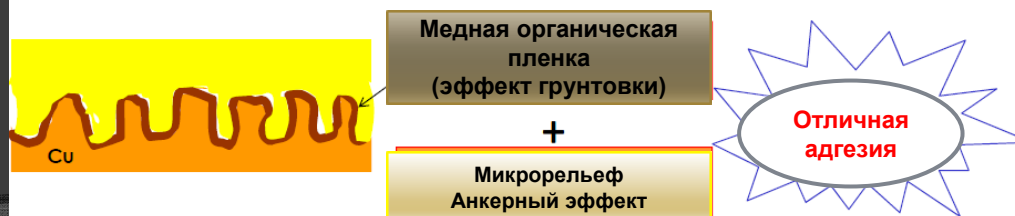
Использование



BO-7710 V это альтернативный способ обработки черного оксидирования меди(& уменьшенный)

H₂SO₄-H₂O₂ это способ химического микроотравления

Этот химический раствор может создавать уникальную поверхность топографии и великолепную адгезию на пленке с органической медью



Коричневый оксид

MEC V-BOND BO7710 V

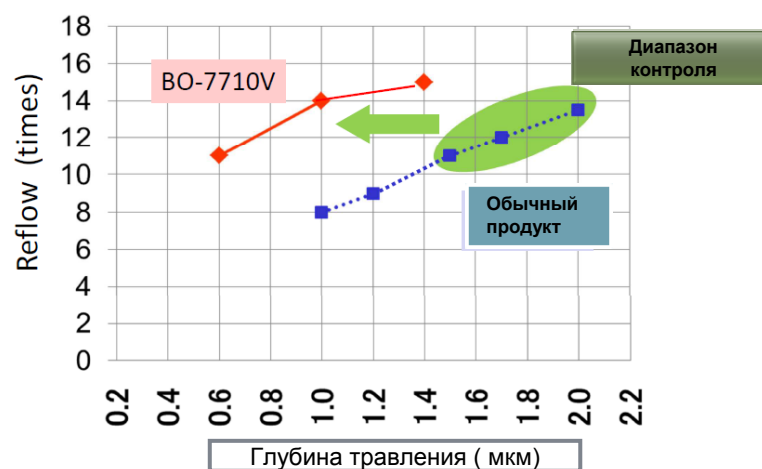
ОСОБЕННОСТИ:

- Низкий объем травления
- Нет предварительного процесса погружения
- Автоматический анализатор
- Простота обслуживания

Сохраняя эффективную производительность BO 7710, экономит эксплуатационные расходы, расходы на техническое обслуживание и т.д.

Коричневый оксид МЕС V-BOND BO7710 V

1. Низкая глубина травления



Почему?

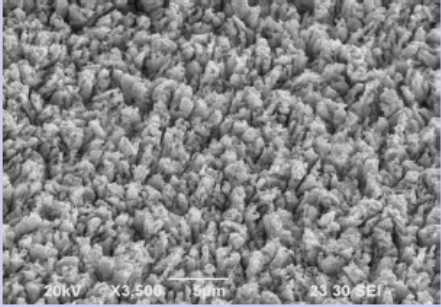
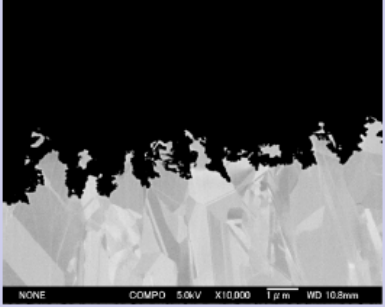
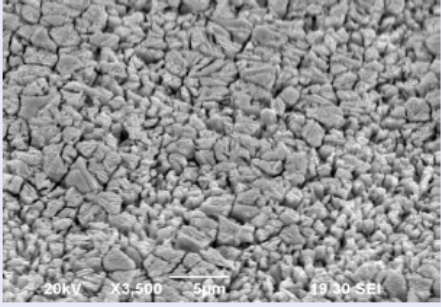
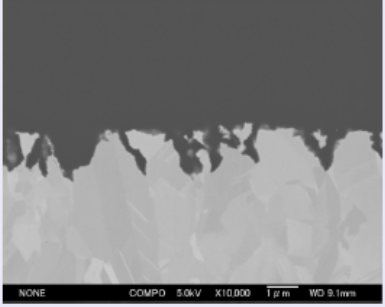
	Обычный продукт 2.0um	BO-7710V 1.0um
Поперечный разрез X10,000		
Ra	0.38	0.33
Rz	4.01	4.13

Шероховатая поверхность состава раствора BO-7710V с глубиной травления 1 мкм соответствует глубине травления 2 мкм обычного раствора

Коричневый оксид

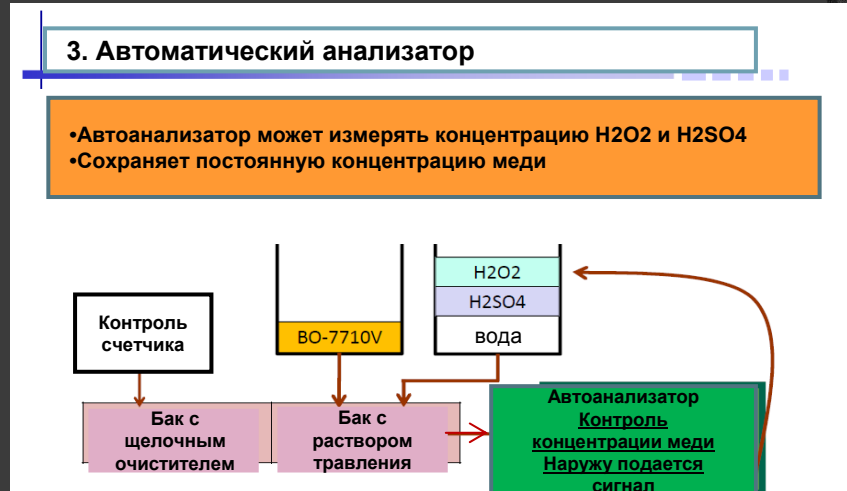
МЕС V-BOND B07710 V

ТОПОГРАФИЯ:

	Surface structure (x3,500)	Cross section (x10,000)
Conventional Product 2.0um		
BO-7710V 1.0um		

BROWN OXIDE MEC V-BOND BO7710 V

ПРОЦЕСС:



4. Техническое обслуживание

Баки и фильтры частично загрязняются раствором BO-7710V
После 6 месяцев бак с раствором BO-7710V становится грязным, как это показано на рисунке.



	Обычный состав раствора	BO-7710V
Рабочий раствор Время/мес	1 Это не зависит от травления и количества панелей	3-6
Цикл смены фильтра Время/мес	1 В этом же рабочем растворе	3-6 В этом же рабочем растворе

МЕС HASL FLUX W-2365 XP

ЭКОНОМИЧНАЯ ЦЕНА

FLUXES

MEC HASL FLUX W-2365 XP

Использование:

- ⦿ Флюс для горячего лужения

Особенности:

- ⦿ Хорошая совместимость
- ⦿ Не содержит свинца
- ⦿ Выдерживает струю воды
- ⦿ Высокий уровень паяльной способности поверхности
- ⦿ Остатки после пайки полностью растворимы в воде и легко удаляются путем промывки водой
- ⦿ Очень низкая задымляемость, очень низкие карбоновые остатки
- ⦿ Защищает от брызг попадания на припой.
- ⦿ Нет проблем от шариков и перемычек припоя

Удаление металлорезиста

- ◎ MEC REMOVER S-1728: снятие Sn/Pb

- ◎ MEC REMOVER NH-1866: снятие Ni

MEC REMOVER S-1728

Пошаговый и готовый к использованию
Без фтора, без перекиси водорода
раствор для снятия Sn/Pb

METAL STRIPPER

MEC REMOVER S-1728

Использование:

- Снятие Sn/Pb

Особенности:

- Пошаговый и готовый к использованию
- Без фтора, без перекиси водорода и на основе азотной кислоты
- Нет опасности для пятен.
- Быстрая скорость снятия (10-15 мкм/мин)
- Очень низкое действие на поверхность меди
- Легкая утилизация
- Производительность : до 190 г/л для Sn(Pb) при постоянной скорости.

MEC REMOVER NH-1866

Раствор для снятия Nickel

Раствор для снятия никеля

MES REMOVER NH-1866

Использование:

- ⦿ Травление Ni или сплава Ni/Cu

Особенности:

- ⦿ Химический и Электролитический Nickel
- ⦿ Низкая скорость травления Ni (менее 0.4 мкм/мин)

METAL STRIPPER

MES REMOVER NH-1866

Рабочий раствор:

- Дистиллированная вода 60%
- 62.5% HNO_3 30%
- NH-1866 10%

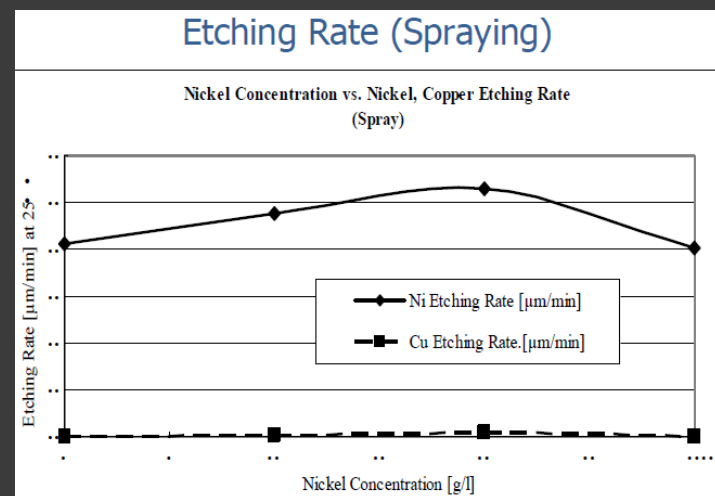
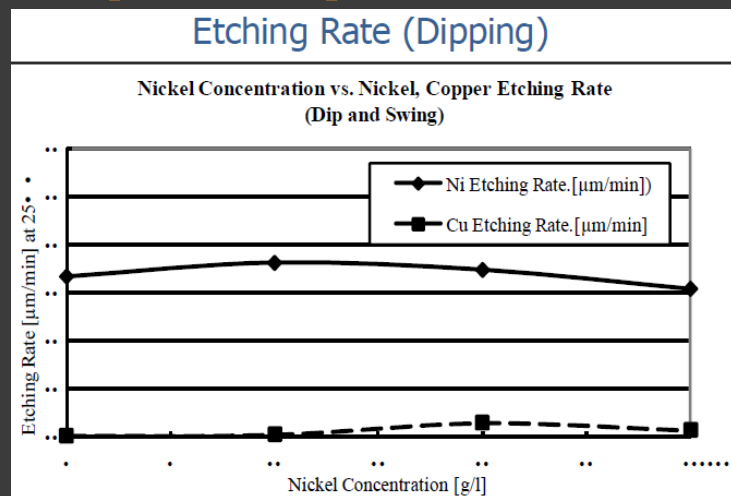
Добавить 70г/л 35% H_2O_2 в раствор смеси

Контроль растворов в баках:

- Концентрация кислоты
- Концентрация никеля
- Концентрация перекиси водорода
- Скорость травления меди

METAL STRIPPER MEC REMOVER NH-1866

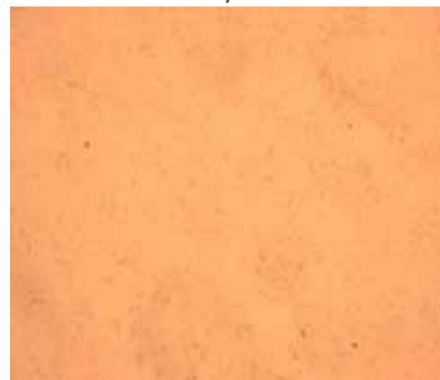
Характеристики:



Etched by Former Product



Etched by NH-1866



Меньше
осталось
никеля на
поверхности
меди

CCI & MEC ВАШИ ПАРТНЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

В ваших руках есть все возможности сделать
правильный технической и разумный выбор!!!

**СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!!!**

Есть ли у Вас вопросы?